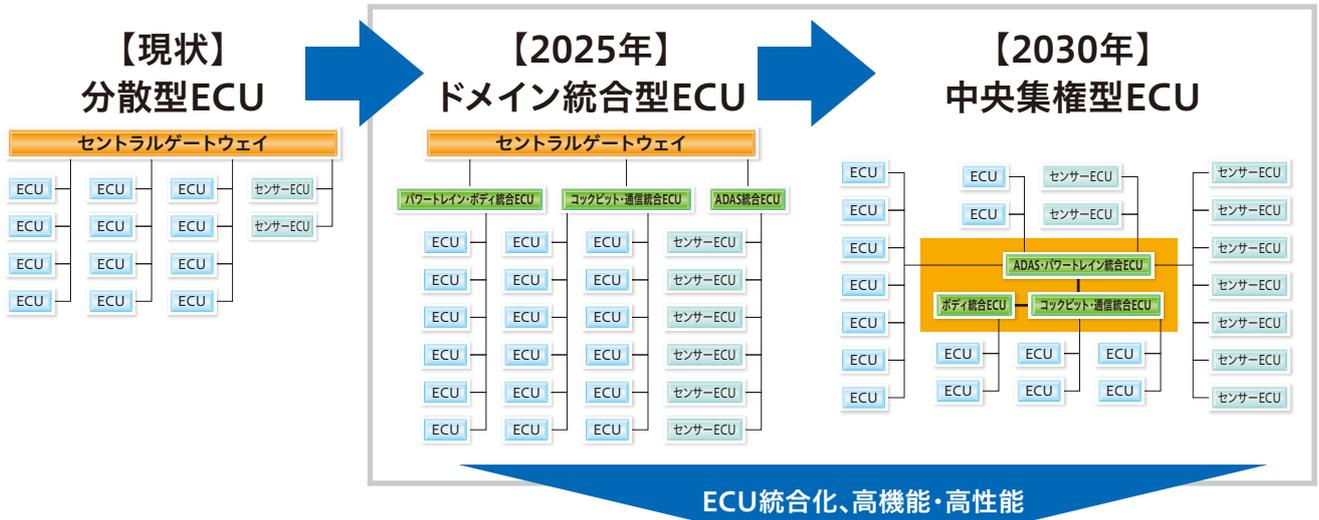


車載用途プリント配線板 技術ラインナップ

Automotive PWB Technology Lineup

プリント配線板に求められる技術



高密度・高周波

部品高機能・高性能化⇒狭ピッチ配線
高速信号通信⇒高周波対応

小型化

省スペース化
3D実装対応

放熱

部品発熱⇒プリント配線板での放熱対応

技術ロードマップ

製品課題	開発アクション	24年度	25年度	26年度
更なる統合化への対応	高周波 伝送ロス低減	高周波材の選定	低誘電材料評価	
		パターン形成性精度(銅めっき/積層膜厚精度含む)	パターン形成法の評価	
		無粗化処理	無粗化処理の検討	
	大電流化による 発熱対策	ノイズ対策	受動部品によるノイズ対策	構造検討、チップ選定等
			スタブ対策	バックドリル評価
		高耐熱部材の選定	高Tg基材の選定	性能評価
高電圧、高温対応 SiC内蔵構造 ON/OFFサイクルの ロス低減	高耐圧/高耐熱構造	高TgSRの選定	更なる耐クラック向上SR開発中	
		実装信頼性の向上	低CTE材の選定	低CTEでの信頼性評価
		高Tg基材の選定	材料特性検討	
	耐トラッキング性	高TgSRの選定	更なる高TgSR開発中	
		スキップVia	深Viaのレーザ径+フィールド技術	
		耐電圧/高放熱材	材料特性評価	
無粗化処理	薬液評価			
	異物対策	検査方法など検討中		